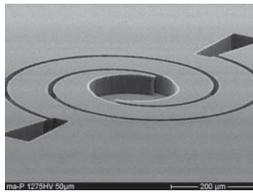
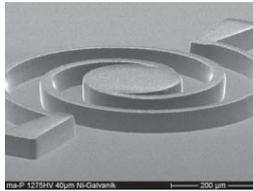


# Лист технической информации *micro resist technology* ma-P 1275 и ma-P 1275 HV – позитивные фоторезисты

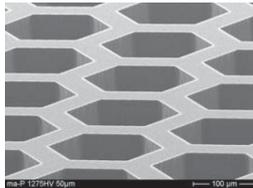
Универсальные позитивные фоторезисты высокой вязкости для микросистемных технологий



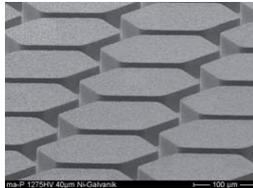
ma-P 1275 HV 50 мкм



гальванически осадженный никель (Ni) 40 мкм



ma-P 1275 HV 50 мкм



гальванически осадженный никель (Ni) 40 мкм



ma-P 1275 HV 30 мкм, спираль 20 мкм



гальванически осадженный никель (Ni) 25 мкм, спираль 20 мкм

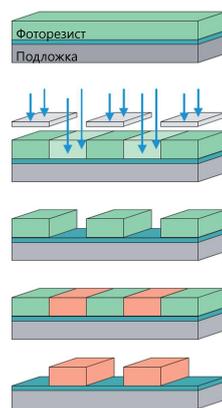
Все топологии резистов получены посредством экспонирования полным спектром ртутной лампы, произведенного установкой смещения и экспонирования

## Характеристики

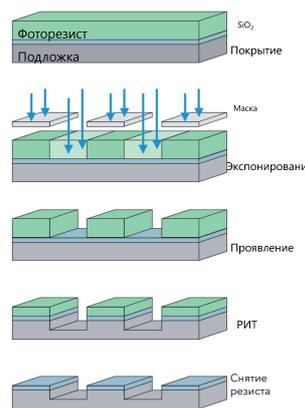
- Специально разработаны для гальванического осаждения структур в микросистемных технологиях.
- Высокая стойкость в кислотных и щелочных гальванических ваннах.
- Также хорошо подходят для использования в качестве маски для травления, демонстрируя высокую стойкость к сухому и влажному травлению.
- Достигается хорошая термическая стабильность топологии резиста.
- Проявление в водно-щелочных растворах.
- Легко снимаются.
- Клин травления до 87° с экспонированием полным спектром ртутной лампы, производимым установкой совмещения и экспонирования

## Процесс

### < гальваническое осаждение >



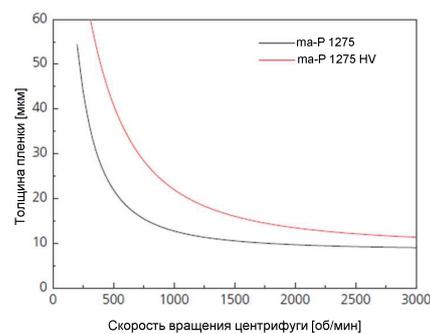
### < травление >



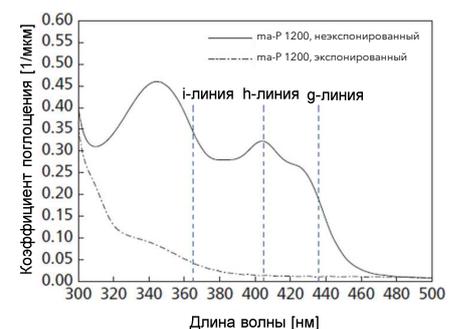
## Толщина пленок

Толщина пленки	мкм	7,5	11	20	30	40	50
ma-P 1275	об/мин/с	3000	500	350	250	-	-
		30	60	60	60	60	-
ma-P 1275 HV	об/мин/с	3000	1100	700	500	400	400
		30	60	60	60	60	60

## Кривые нанесения

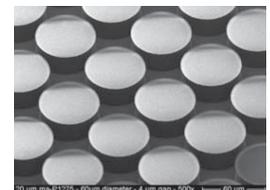


## Спектры УФ / видимого света

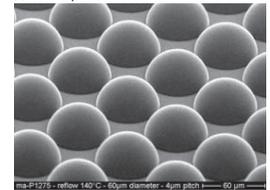


## Области применения

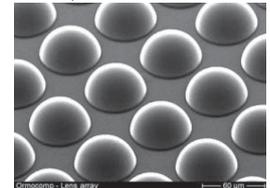
- Форма для гальванического осаждения, например для микроspirалей, микропружин, микрооптических компонентов
- Маска для травления металлических и полупроводниковых подложек, например микролинзы из оплавленных топологий
- Маска для ионной имплантации



Столбики ma-P 1275 20 мкм, диаметр 60 мкм



Оплавленный ma-P 1275 30 мкм, диаметр 60 мкм



Топология, переданная в OrtoComr посредством двукратного формования под действием УФ-излучения



## ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru